蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書

蒐集個人資料告知事項：

為遵守個人資料保護法規定，在您提供個人資料予本院前，依法告知下列事項：

一、智慧財產及商業法院（以下簡稱本院)為相關行政業務需求之特定目的而獲取您所附個人履歷（申請書、報名表）及其他得以直接或間接識別您個人之資料，並建立您個人資料檔案。

二、本院為執行法定職務之必要，亦會蒐集您個人犯罪前科、監護或輔助宣告等個人資料。

三、本院將依個人資料保護法及相關法令之規定下，依本院隱私權保護政策，蒐集、處理及利用您的個人資料。

四、本院將於前開蒐集目的之存續期間，及於原蒐集之特定目的範圍內，合理利用您的個人資料。

五、除蒐集之目的涉及國際業務或活動外，本院僅於中華民國領域內利用您的個人資料。

六、您可依個人資料保護法第 3 條規定，就您的個人資料，隨時以書面向本院行使之下列權利：

(一)查詢或請求閱覽。

(二)請求製給複製本。

(三)請求補充或更正。

(四)請求停止蒐集、處理及利用。

(五)請求刪除。

您因行使上述權利而導致對您的權益產生減損時，本院不負相關賠償責任。

七、若您未提供正確之個人資料，本院將無法為您提供特定目的之相關業務。

八、本院因業務需要而委託其他機關處理您的個人資料時，將善盡監督之責。

九、您瞭解此一同意書符合個人資料保護法及相關法規之要求，且同意本院留存此同意書，供日後取出查驗。

個人資料之同意提供：

一、本人已充分知悉貴院上述告知事項。

二、本人同意貴院蒐集、處理、利用本人之個人資料。

立同意書人：_____

身分證統一編號：_____

中華民國　　年　　月　　日